

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州美卡乐光电有限公司（以下分别简称“士兰集昕”、“士兰集成”、“士兰明芯”、“美卡乐”），均为本公司之控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年3月1日至2023年3月31日，公司为士兰集昕提供担保金额为人民币3.40亿元；为士兰集成提供担保金额为人民币1.80亿元；为士兰明芯提供担保金额为人民币0.25亿元；为美卡乐提供担保金额为人民币0.25亿元。

截至2023年3月31日，公司为士兰集昕实际提供的担保余额为10.84亿元；为士兰集成实际提供的担保余额为6.36亿元；为士兰明芯实际提供的担保余额为1.77亿元；为美卡乐实际提供的担保余额为1.32亿元；担保余额均在公司2021年年度股东大会批准的担保额度范围内。

- 本次担保无反担保。
- 本公司不存在逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保进展情况

2023年3月1日至2023年3月31日，公司在年度预计担保金额内实际发生如下担保：

（1）公司于2023年3月8日向招商银行股份有限公司杭州分行出具了《不可撤销担保书》，就士兰集昕融资事宜提供连带责任保证担保，担保金额为人民币0.40亿元。

（2）公司于2023年3月15日与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签署了《最高额保证合同》，就士兰集成融资事宜提供连带责任保证担

保，担保的最高本金余额为人民币 1.10 亿元。

(3) 公司于 2023 年 3 月 16 日与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行签署了 4 份《本金最高额保证合同》，就美卡乐、士兰集昕、士兰集成、士兰明芯融资事宜分别提供连带责任保证担保，担保的最高本金余额分别为人民币 0.25 亿元、3.00 亿元、0.70 亿元、0.25 亿元。

(4) 截至 2023 年 3 月 31 日，公司为士兰集昕实际提供的担保余额为 10.84 亿元，剩余可用担保额度为 2.16 亿元；为士兰集成实际提供的担保余额为 6.36 亿元，剩余可用担保额度为 1.64 亿元；为士兰明芯实际提供的担保余额为 1.77 亿元，剩余可用担保额度为 1.23 亿元；为美卡乐实际提供的担保余额为 1.32 亿元，剩余可用担保额度为 0.68 亿元；担保余额均在公司 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内。

## (二) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第三十三次会议和 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于本公司 2022 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2022 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过 32 亿元，其中对士兰集昕担保不超过 13 亿元；对士兰集成担保不超过 8 亿元；对士兰明芯担保不超过 3 亿元；对美卡乐担保不超过 2 亿元。上述金额包含以前年度延续至 2022 年度的担保余额，且在 2022 年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日和 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2022-017、临 2022-023 和临 2022-033。

本次担保在公司 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 各公司的基本情况如下：

公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	本公司持股比例 (%)		主营业务
						直接	间接	

杭州士兰集昕微电子股份有限公司	91330101MA27W6YC2A	2015年11月4日	浙江杭州	陈向东	224,832.8735	36.00	32.35	芯片制造
杭州士兰集成电路有限公司	913301017265863549	2001年1月12日	浙江杭州	陈向东	60,000	98.75		芯片制造
杭州士兰明芯科技有限公司	913301017654845885	2004年9月24日	浙江杭州	范伟宏	90,000	57.78	41.69	LED 芯片制造
杭州美卡乐光电有限公司	91330101689094018G	2009年7月2日	浙江杭州	江忠永	17,000	43.00	56.29	LED 封装

(二) 截至 2022 年 12 月 31 日, 各公司经审计的主要财务数据如下:

(单位: 人民币 万元)

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
士兰集昕	364,697.69	155,401.52	209,296.17	131,345.45	-1,719.82
士兰集成	197,515.26	96,847.20	100,668.06	155,477.64	-1,460.17
士兰明芯	97,920.44	39,117.94	58,802.50	44,161.87	-8,851.90
美卡乐	44,480.56	26,399.80	18,080.76	26,348.32	3,549.70

(三) 士兰集昕、士兰集成、士兰明芯、美卡乐均为本公司的控股子公司, 均未被列为失信被执行人, 均不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限	是否有反担保	是否为关联担保
杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	担保的债权额为人民币 0.40 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。	无	否
杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	担保的最高本金余额为人民币 1.10 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间, 各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。	无	否
杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的最高本金余额为人民币 0.25 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算, 即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。	无	否
杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的最高本金余额为人民币 3.00 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达	无	否

杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的最高本金余额为人民币 0.70 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	成展期协议的, 保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意, 保证人仍需承担连带保证责任。	无	否
杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰明芯科技有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的最高本金余额为人民币 0.25 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	若发生法律法规规定或主合同约定的事项, 债权人宣布债务提前到期的, 保证期间至债务提前到期之日后三年止。	无	否

#### 四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足上述控股子公司日常生产经营的资金需求, 有利于公司主营业务的发展; 被担保人均为公司合并报表范围内的子公司, 具备良好的偿债能力, 风险可控。

#### 五、董事会意见

公司于 2022 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第三十三次会议和 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会, 审议通过了《关于本公司 2022 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》; 公司独立董事就该担保事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日和 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告, 公告编号为临 2022-017、临 2022-023 和临 2022-033。

#### 六、累计对外担保数量

截止本公告披露日, 公司及控股子公司批准对外担保总额为 46.566 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 63.15%。公司对控股子公司提供的担保总额为 34.13 亿元、控股子公司之间提供的担保总额为 1.37 亿元, 合计占公司最近一期经审计净资产的 48.14%; 公司为参股公司厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为 8.216 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 11.14%; 公司为参股公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司提供的担保总额为 2.85 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 3.87%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。(担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。)

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023年4月4日